



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100915000
2010 年 11 月 17 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA(ハイパフォーマンスアナログ) VSP5000PM 製品 前処理サイト追加のご案内

(初版 PCN20100915000 2010 年 9 月 21 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	HPA(ハイパフォーマンスアナログ) VSP5000PM製品 前処理サイト追加 現行 : TSMC-WF3社(台湾) 変更後 : TSMC-WF3社(台湾), Vanguard社(台湾)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2011年1月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容 : 弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) VSP5000PM製品の0.35um DPTMプロセス前処理サイトについて、現行 TSMC-WF3社(台湾)サイトにて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、Vanguard社(台湾)サイトでの製造を追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
前処理サイト	TSMC-WF3社(台湾)	TSMC-WF3社(台湾) Vanguard社(台湾)

理由 : 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名	
VSP5000PM	VSP5000PMG6

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記の様になります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TSMC-WF3	Vanguard
CSO (20L): 前処理サイト記号	TS5	VAN
CCO (21L): 生産国記号	TWN	TWN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果			
信頼性試験期間	開始	終了	2010年11月5日
信頼性試験 - 試料構成詳細			
Qual Device:	VSP5000PM	Die Size (mm):	3.12 X 3.2
Wafer Fab Site:	Vanguard	Wafer Fab Process:	0.35um DPTM
MSL:	JEDEC L-1/260C	Metallization:	AlCu
信頼性試験結果			
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
Electrical Char.	per datasheet parameters	Approved	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	終了	2007年4月6日	
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	VSP5100PDT	Die Size (mm):	7.28 x 7.58	
Wafer Fab Site:	Vanguard	Wafer Fab Process:	0.35um DPTM	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp Life	125C, 1000 hours	40/0	40/0	40/0
**Storage Life	150C, 1000 hours	27/0	27/0	27/0
**HAST	135C/85%, 96 hours	27/0	27/0	27/0
*** Autoclave	121C, 96 hours	27/0	27/0	27/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	27/0	27/0	27/0
**Thermal Shock	-65/150C, 500 cycles	27/0	27/0	27/0
Latch Up	-	6/0	-	-
ESD - HBM	2500V	22/0	22/0	22/0
ESD - CDM	500V	3/0	-	-
Notes: ** Test requires Pre-Conditioning, JEDEC L-3/260C				